

## ニュースリリース

### 「最大 24 個のマルチ・ローレンツ・ドルーデ係数のサポートと 高屈折率差対応の BPM 法を含む Version 8.3」

日本アールソフトデザイングループ株式会社(代表取締役社長 尾崎透徹 東京都港区芝1-9-6)は米国RSoft Design Group, Inc.(RSoft社)が開発しました光デバイス設計・シミュレーション・ソフトウェア RSoft Passive Component Design Suite Version 8.3の販売を2011年9月7日より開始いたしました。価格は135万円から、初年度販売見込み200本、主に光ファイバ/レーザ・メーカー、太陽電池/光学材料/光部品/光半導体メーカー、デジタル家電/光学機器メーカー、WDM/SONET/SDH装置メーカー、光関連研究機関、大学等に拡販する予定。

最新の複雑なナノ・テクノロジーやLED/有機ELなどの微細な光学部品の開発では、生産性の向上、開発期間の短縮が不可欠です。複雑なシリコンのような波長-分散をもった材料をパルス解析するには少ないマルチ・ローレンツ係数でのフィッティングでは不十分です。最大24個までのマルチ・ローレンツ・ドルーデ係数をサポートしたVersion 8.3では高精度なフィッティングが可能です。またBPM法によるシリコン導波路の解析もより正確に行えるようになります。

#### RSoft Passive Component Design Suite Version 8.3の主な新機能

- 最大 24 個までのマルチ・ローレンツ・ドルーデ係数のサポートが可能  
PEC のサポートとエリプソ等で測定した複雑な波長分散を有する材料の詳細なデータ・フィッティング
- BeamPROP の高屈折率差解析機能の強化によるシリコン導波路解析への対応  
ファイバとシリコン細線導波路へのスポット・サイズ変換器のシミュレーションが可能
- 最新のダイナミック・アレイ・レイアウト機能で、周期的な構造を生成した後でも簡単に変更が可能
- リング、バネ構造、などの複雑な 3 次元構造でも容易にモデル化が可能  
プロファイル(断面形状や屈折率分布)、テーパ(長さ方向の大きさや屈折率の変化)、ねじれ(長さ方向の断面形状の回転)、などをダイナミック・アイコンのクリックおよび属性の設定で操作
- グループ操作による容易な編集(コピー、移動、サイズ変更、マテリアル属性、等)
- ビュー・ランチ・ボタンで入射光の分布を解析前に確認可能
- 新製品の LED ユーティリティによる光取り出し効率の計算
- RSoft Passive Component Design Suite Version 8.3 は Windows XP SP3/Vista/7、Linux 環境で稼働します。
- 記載されている社名や製品名は各社の登録商標または商標です。

#### より詳細な情報は

日本アールソフトデザイングループ株式会社

〒105-0014 東京都港区芝 1-9-6 マツラビル 2F

電話: 03-5484-6670 FAX: 03-5484-2288

URL: <http://www.rsoftdesign.co.jp/>

Email: [akagi@rsoftdesign.co.jp](mailto:akagi@rsoftdesign.co.jp)

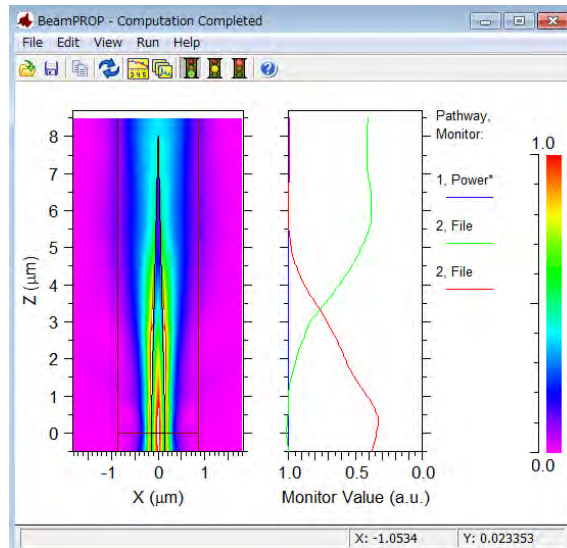
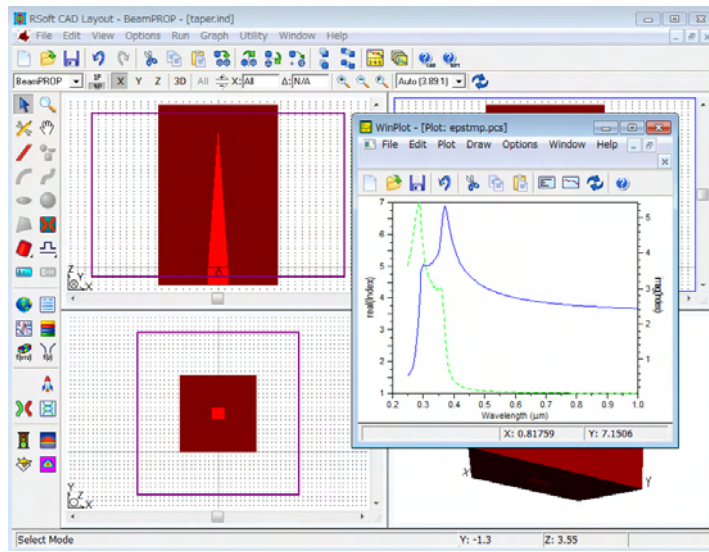


図 詳細なシリコンのドルーデ・モデルと高屈折率差対応の BeamPROP による Si 導波路の解析